

产品碳足迹核查概述

该公司

和舰芯片制造（苏州）股份有限公司

中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星华街 333 号

制造地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星
华街 333 号

报告

和舰芯片 8 寸晶圆产品碳足迹评估报告

产品 / 功能单位

1 片 8 寸晶圆从摇篮到大门的碳足迹为 345.57 千克二氧化碳当量。

该公司所提供的产品碳足迹计算及报告已经过 SGS 核查，
其计算符合 ISO 14040:2006 环境管理 - 生命周期评价 - 原则和框架、
ISO 14044:2006 环境管理 - 生命周期评价 - 要求和指南、
ISO 14067:2018 温室气体排放 - 产品碳足迹 - 量化要求与指南。

此次核查基于上述组织于 2024 年 5 月 15 日提交的报告及其支持性材料，
详情请见报告：和舰芯片 8 寸晶圆产品碳足迹评估报告 2024/PCFV/C/0510。



碳足迹
可持续发展服务

签署

颁发日期：2024 年 06 月 04 日

绿色产品服务

自愿性产品认证中心

通标标准技术服务有限公司

中国上海徐汇区宜山路 900 号 B 座 11 楼 邮编 200233

t + 86 (0)21 6140 2666 f + 86 (0)21 6115 2359 www.sgsgroup.com.cn

Page 1 of 2



CN/RMSC/PCFV/2024/05/010, 续

报告

和舰芯片 8 寸晶圆产品碳足迹评估报告

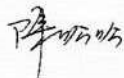
产品/功能单位

1 片 8 寸晶圆从摇篮到大门的碳足迹为 345.57 千克二氧化碳当量。

产品碳足迹资料概述如下:

申请者:	和舰芯片制造(苏州)股份有限公司
申请者地址:	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区 星华街 333 号
制造地址:	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星 华街 333 号
产品描述:	和舰芯片 8 寸晶圆
数据收集:	该公司所提供的产品碳足迹计算及报告根据 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的收集数据, 已经过 SGS 核查。
计算方法:	经 SGS 核查该计算符合 ISO 14040:2006 环境管理 - 生命周期评价 - 原则和框架、ISO 14044:2006 环境管 理 - 生命周期评价 - 要求和指南、ISO 14067:2018 温 室气体排放 - 产品碳足迹 - 量化要求与指南。
系统边界:	经 SGS 核查, 该计算按照生命周期评价的原则来计算 产品从摇篮到大门的碳足迹。
温室气体的计算:	二氧化碳当量值是按其单位辐射强迫换算而成, 换算时 采用政府间气候变化专业委员会(IPCC 2021, 表 7.SM.7)定义的 100 年全球增温潜势。 温室气体已列于 IPCC 2021, 表 7.SM.7。
SGS 报告号:	SGS/RMSC/2024/PCFV/C/0510

签署



颁发日期: 2024 年 06 月 04 日

绿色产品服务

自愿性产品认证中心

